
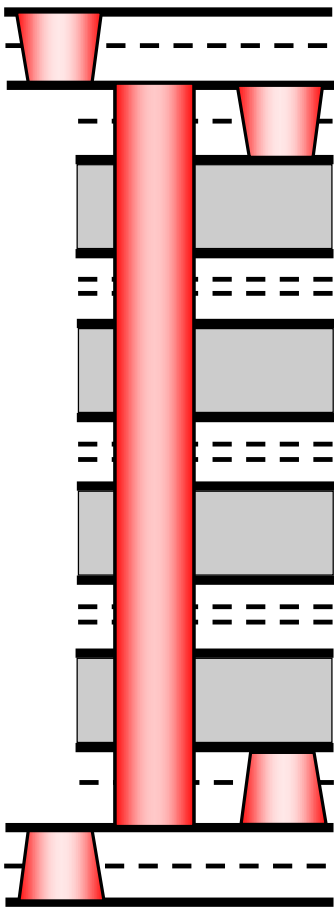


STANDARDLAGENAUFBAU HDI											
HDI12_2+8(10b)+2_1,55_35		12 - Lagen Kerne: 0,15 mm Cu 35/35 µm									
WE-Artikel Nr.:		2 + 8(10B) + 2									
KUNDE:											
LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU			BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG		
KUNDE	WE							[µm]	[µm]		
1	TOP/VS				Folie	12 µm	1)	12			
									1 x 1080	60	
2	VSK1				Folie	9 µm		30			
									1 x 1080	60	
3	2					35 µm		33			
					0,150 mm			150			
4	3					35 µm		33			
									2 x 1080	124	
5	4					35 µm		33			
					0,150 mm			150			
6	5					35 µm		33			
						2 x 1080	124				
7	6		35 µm		33						
		0,150 mm			150						
8	7		35 µm		33						
						2 x 1080	124				
9	8		35 µm		33						
		0,150 mm			150						
10	9		35 µm		33						
						1 x 1080	60				
11	RSK1		9 µm		30						
						1 x 1080	60				
12	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12						
					1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm						
					Gesamtdicke Material:		1560				
Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)											
MATERIALDICKE:		1,55	+/-	0,13	mm	Datum:		Bearbeiter:			
DICKE über galv. Endoberfläche		1,64	+/-	0,16	mm						
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer		1,70	+/-	0,18	mm						
Kundenforderung:			+/-		mm	Messstelle:					
Erstellt am		von		Geprüft am		von		Freigegeben am		Revision	
29.03.2006		S.Keller		04.05.2006		M.Kress		04.05.2006		R.Schönholz	
								00		Seite: 13+	